

特点:

- LO to RF 隔离度: 典型值 30dB
- 插入损耗: 典型值 8dB
- 本振电平: 10dBm
- 封装尺寸: 12.5×5.7×6.6mm³(不含引脚)
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

性能参数 (25℃):

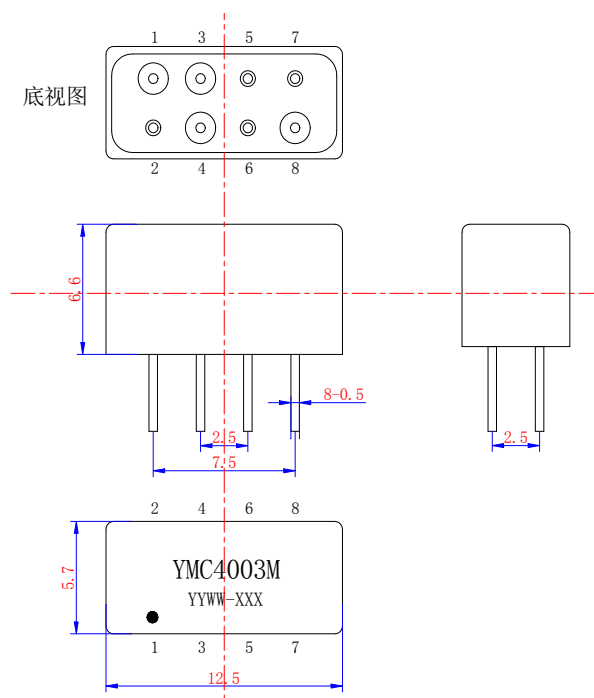
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围(RF & LO)	f	Z _{in} =Z _{out} =50Ω	0.01		2	GHz	全温
频率范围(IF)	f		DC		1.3	GHz	全温
变频损耗	IL	Z _{in} =Z _{out} =50Ω RF & LO=0.01~2GHz IF=30MHz LO=10dBm		8	8.5	dB	全温
隔离度 (LO to RF)	ISO _{LO to RF}		25	30		dB	
隔离度 (LO to IF)	ISO _{LO to IF}		25	30		dB	
输入-1dB 压缩点	P _{-1dB}		4	6		dBm	
工作温度	T		-55		+85	℃	
质量	m				5	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
储存温度	-55~+100	℃	输入射频功率	15	dBm
本振功率	20	dBm			

封装外形图:

单位: mm 公差: ±0.2mm



字符标志：

YMC4003M	产品型号
•	1 脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义：

引脚	定义	说明
1	RF	射频输入端
3	IF	中频输出端
4	IF	中频输出端
8	LO	本振输入端
其他	GND	接地端

产品使用注意事项：

- 1.产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚）。
- 3.产品推荐采用波峰焊接使用或手工焊接使用。采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒。
- 4.对于产品的引脚，不建议对引脚进行成型处理，如因特殊要求需对引脚做成型处理的，需提前同宇熙设计人员进行确认，避免成型不当造成产品可靠性风险。
- 5.产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 6.客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。